

信頼性試験結果

製品名：S-93C56BD0H -T8TxU

搭載パッケージ：8-Pin TSSOP

No.	試験名	試験条件	時間	r/n	故障判定基準
1	高温動作	Ta=125 °C, V = Vopr max.	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
2	高温高湿バイアス #1	Ta=85 °C, RH=85 % V = Vopr max.	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
3	プレッシャクッカ・バイアス #1	Ta=125 °C, RH=85 %, P=2×10 ⁵ Pa V = Vopr max.	100 h	0/22	製品規格を満足すること
4	高温保存	Ta=150 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
5	低温保存	Ta=-65 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
6	書き換えサイクル -1	Ta=85 °C, V _{CC} = Vopr max.	1 × 10 ⁶ cycles	0/22	製品規格を満足すること
7	書き換えサイクル -2	Ta=105 °C, V _{CC} = Vopr max.	5 × 10 ⁵ cycles	0/22	製品規格を満足すること
8	温度サイクル (気相) #1	Ta=150 °C ⇔ -65 °C, 各 15 分	500 cycles	0/22	製品規格を満足すること
9	はんだ耐熱性 1 (リフロー) #2	T=260 °C, 10s	3 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
10	はんだ耐熱性 2 (はんだゴテ) #2	T=380 °C, 5s (はんだコテ先温度) 対象：リード部	2 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
11	はんだ耐熱性 3(フロー) #2	T=260 °C, 10s	1 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
12	はんだ付け性 #3	T=245 °C はんだ材：Sn-3.0Ag-0.5Cu	5 s	0/11	ゼロクロスタイムが 3 秒以内 であること 半田浸漬部分の 95%以上が 半田で覆われること
13	ウイスカ 1 (室温保存)	Ta=30 °C, RH=60%	4000h	0/6	ウイスカサイズが 40 μm 以下 であること
14	ウイスカ 2 (温度サイクル)	Ta=85 °C ⇔ -40 °C	1500 cycles	0/6	ウイスカサイズが 45 μm 以下 であること
15	ウイスカ 3 (高温高湿保存)	Ta=55 °C, RH=85 %	4000h	0/6	ウイスカサイズが 40 μm 以下 であること
16	はんだ接合信頼性 (せん断強度) #3	Ta=125 °C ⇔ -40 °C はんだ材：Sn-3.0Ag-0.5Cu	2000 cycles	0/22	初期強度値の 50%以上の 強度を維持すること
17	リード引っ張り強度	引張力：1.0N	30 s	0/11	リードが脱落しないこと
18	リード曲げ強度	引張力：0.5N 45 度折り曲げ	2 回	0/11	リードが脱落しないこと
19	静電耐圧 1(HBM)	V=±2000 V, C=100 pF, R=1.5 kΩ V _{CC} 基準, GND 基準	5 回	0/5	製品規格を満足すること
20	静電耐圧 2(CDM)	V=±500 V 帯電, 接地放電	1 回	0/5	製品規格を満足すること
21	ラッチアップ強度 (パルス電流注入法)	±100 mA, V = Vopr max.	1 回	0/5	ラッチアップしないこと

注) Vopr max.=最大動作電圧

#1,2,3：前処理を実施後、シリーズに試験を実施する。

前 処 理 (#1)		
高温保存	吸湿処理	熱 処 理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=85 °C RH=85 % t=168 h	リフロー3回 T=260 °C t=10 s

前 処 理 (#2)		
高温保存	吸湿処理	熱処理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=85 °C RH=85% t=168 h	—

前 処 理 (#3)		
高温保存	吸湿処理	熱処理
—	Ta=105 °C RH=100% t=8 h	—